

# LCP 日本宝理 E471i BK210P连接器专用LCP塑胶原料详情进入

产品名称	LCP 日本宝理 E471i BK210P连接器专用LCP塑胶原料详情进入
公司名称	浩正新材料科技（东莞）有限公司
价格	.00/个
规格参数	赛钢POM:连接器专用LCP塑胶原料 PFA铁氟龙:光学镜头COC材料 COC材料:PFA铁氟龙粒子粉末
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶路1号55号楼106室
联系电话	18825708836 13794983753

## 产品详情

LCP塑胶原料具有突出的耐腐蚀性能，LCP制品在浓度为90%的酸及浓度为50%的碱存在下不会受到侵蚀，对于工业溶剂、燃料油、洗涤剂及热水，接触后不会被溶解，也不会引起应力开裂。

热塑性塑料(Thermo plastics)：指加热后会熔化，可流动至模具冷却后成型，再加热后又会熔化的塑料，即可运用加热及冷却，使其产生[可逆变化](液态 固态)，是所谓的物理变化。

尼龙-66。一种热塑性树脂，白色固体，密度1.14，熔点253，不溶于一般溶剂，仅溶于间苯甲酚等。机械强度和硬度很高，刚性很大，可用作工程塑料。洛氏硬度108-118，热变形温度（1814.11帕，18.5公斤力/厘米<sup>2</sup>）66-86。用作机械附件，如齿轮、润滑轴承；代替有色金属材料做机器外壳，汽车发动机叶片等。也可用于制合成纤维。

绝缘材料：PEEK因具有优良的电气性能，在高温、高湿等恶劣条件下，聚醚醚酮的绝缘性能仍能保持，是理想的电绝缘材料，特别是在半导体工业中得到广泛应用。

POM极易分解，分解温度为280度，分解时有刺激性和腐蚀性气体发生。故模具钢材宜选用耐腐蚀性的材料制作

用作化工防腐蚀泵的壳体、叶片、齿轮泵的齿轮、阀门、管配件及衬里、单向阀的零件、密封件的试验器皿等；

医疗器械：可在134℃下经受3000次循环高压灭菌，这一特性能满足灭菌要求高、需反复使用的手术和牙科设备的制造，加上它的抗蠕变和耐水解性，用它可制造需高温蒸汽消毒的各种医疗器械。尤为重要是PEEK无毒、质轻、耐腐蚀，是与人体骨骼最接近的材料，因此可采用PEEK代替金属制造人体骨骼。

PBT塑胶材料常被用于生产2.54间距180度/90度的排母连接器产品之上，塑料端子壳的耐焊接温度只有

200度左右，由于成本相对其它材料低、强度高、耐摩擦等特性，现在这种材料还是有很多客户选择。但是使用这种材料的成型性较差、缩水严重、由于熔化温度较低、过波峰焊时会产生塑料熔化现象。

PP塑胶原料比水还轻，因此其制品自然很轻巧，另外，多数塑料还有美观大方的外观，如光亮、透明等，更兼塑胶原料着色容易，可使制品具有各种绚丽多彩的颜色，使得制品大受人们欢迎。

POM的熔体粘度对剪切速率敏感。因此，要提高熔体流动性，不能单用提高温度，也要从提高注射速率和注射压力着手。大浇口、厚壁短流程、小面积的制品，注射压力为40~80MPa；一般制品为100MPa左右。小浇口、薄壁长流程、大面积的制品，注射压力较高，为120~140MPa。

一般塑胶原料的刚度比金属低一数量级；

塑胶原料：是由高分子合成树脂(聚合物)为主要成份渗入各种辅助料或某些具有特定用途的添加剂，在特定温度，压力下具有可塑性和流动性，可被模塑成一定形状，且在一定条件下保持形状不变的材料。

热固性塑料(Thermoset plastics)：指的是加热后，会使分子构造结合成网状型态，一旦结合成网状聚合体，即使再加热也不会软化，显示出所谓的[非可逆变化]，是分子构造发生变化(化学变化)所致。

塑胶原料问世仅一百多年，但其发展得却非常的快，这是因为塑胶原料具有许多卓越而独特的性能所赋予的

LCP塑胶原料的特性；

- a、LCP具有自增强性：具有异常规整的纤维状结构特点，因而不增强的液晶塑料即可达到甚至超过普通工程塑料用百分之几十玻璃纤维增强后的机械强度及其模量的水平。如果用玻璃纤维、碳纤维等增强，更远远超过其他工程塑料。
- b、液晶聚合物还具有优良的热稳定性、耐热性及耐化学药品性，对大多数塑料存在的蠕变特点，液晶材料可以忽略不计，而且耐磨、减磨性均优异。
- c、LCP的耐气候性、耐辐射性良好，具有优异的阻燃性，能熄灭火焰而不再继续进行燃烧。其燃烧等级达到UL94V-0级水平。
- d、LCP具有优良的电绝缘性能。其介电强度比一般工程塑料高，耐电弧性良好。在连续使用温度200-300，其电性能不受影响。间断使用温度可达316左右。
- e、LCP具有突出的耐腐蚀性能，LCP制品在浓度为90%酸及浓度为50%碱存在下不会受到侵蚀，对于工业溶剂、燃料油、洗涤剂及热水，接触后不会被溶解，也不会引起应力开裂。

LCP塑胶原料的应用

- a、电子电气是LCP的主要市场：电子电气的表面装配焊接技术对材料的尺寸稳定性和耐热性有很高的要求（能经受表面装配技术中使用的气相焊接和红外焊接）。
- b、LCP：印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动机零件、汽车机械零件、医疗方面。
- c、LCP加入高填充剂或合金（PSF/PBT/PA）作为集成电路封装材料、代替环氧树脂作线圈骨架的封装材料；作光纤电缆接头护套和高强度元件；代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料。代替玻璃纤维增强的聚砜等塑料（宇航器外部的面板、汽车外装的制动系统）。